

# 2011-2015年中国性覆铜板（FCCL）市场调研与 发展前景分析报告

报告大纲

观研报告网

[www.chinabaogao.com](http://www.chinabaogao.com)

## 一、报告简介

观研报告网发布的《2011-2015年中国性覆铜板（FCCL）市场调研与发展前景分析报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/tonglv/8856788567.html>

报告价格：电子版: 6800元 纸介版：7000元 电子和纸介版: 7200

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

### 摘要

性覆铜板是指在聚酯薄膜或聚酰亚胺薄膜等挠性绝缘材料的单面或双面，通过一定的工艺处理，与铜箔粘接在一起所形成的覆铜板。挠性覆铜板广泛用于航空航天设备、导航设备、飞机仪表、军事制导系统和手机、数码相机、数码摄像机、汽车卫星方向定位装置、液晶电视、笔记本电脑等电子产品中。由于电子技术的快速发展，使得挠性覆铜板的产量稳定增长，生产规模不断扩大，特别是高性能的以聚酰亚胺薄膜为基材的挠性覆铜板，其需求量和增长趋势更加突出。

挠性覆铜板（Flexible Copper Clad Laminate，FCCL）（又称为：柔性覆铜板）是挠性印制电路板（Flexible Printed Circuit board，FPC）的加工基板材料，是由挠性绝缘基膜与金属箔组成的。由铜箔、薄膜、胶粘剂三个不同材料所复合而成的挠性覆铜板称为三层型挠性覆铜板（简称“3L-FCCL”）。无胶粘剂的挠性覆铜板称为二层型挠性覆铜板（简称“2L-FCCL”）。挠性覆铜板（FCCL）与刚性覆铜板在产品特性上相比，具有薄、轻和可挠性的特点。用FCCL为基板材料的FPC被广泛用于手机、数码相机、数码摄像机、汽车卫星方向定位装置、液晶电视、笔记本电脑等电子产品中。

### 目录

#### 第一章 挠性覆铜板的品种及主要性能要求

##### 第一节 按不同基材分类的FCCL品种

##### 第二节 按不同构成分类的FCCL品种

##### 第三节 按不同应用领域分类的FCCL品种

##### 第四节 FCCL品种的其他分类

##### 第五节 产品主要采用的标准及性能要求

###### 一、FCCL相关标准

###### 二、FCCL的主要性能要求

#### 第二章 挠性覆铜板的制造工艺法及其特点研究

##### 第一节 三层型FCCL的制造工艺法及其特点

###### 一、片状制造法

###### 二、卷状制造法

##### 第二节 二层型FCCL的制造工艺法及其特点

###### 一、涂布法

###### 二、溅射/电镀法

###### 三、层压法

###### 四、三种工艺法生产的2L-FCCL在性能、工艺特点方面的比较

### 第三节 近年FPC的技术发展方面

#### 一、二层型FCCL已成品种发展的主流

#### 二、FCCL近年在技术方面的进步

### 第三章 2009-2010年世界挠性覆铜板市场发展现状分析

#### 第一节 2009-2010年世界挠性覆铜板产业发展概述

##### 一、挠性覆铜板发展历程

##### 二、世界FCCL市场规模及两品种的比例

##### 三、世界挠性覆铜板市场的规模

#### 第二节 2009-2010年世界挠性覆铜板区域市场分析

##### 一、美国

##### 二、日本

##### 三、德国

##### 四、韩国

### 第三节 2011-2015年世界挠性覆铜板产业发展前景预测分析

### 第四章 2009-2010年世界挠性覆铜板主要企业运营走势分析

#### 第一节 新日铁化学株式会社

##### 一、公司基本概况

##### 二、2009-2010年公司经营与销售情况分析

##### 三、2009-2010年公司竞争优势分析

##### 四、公司国际化战略发展

#### 第二节 宇部兴产株式会社

##### 一、公司基本概况

##### 二、2009-2010年公司经营与销售情况分析

##### 三、2009-2010年公司竞争优势分析

##### 四、公司国际化战略发展

#### 第三节 台湾律胜科技股份有限公司

##### 一、公司基本概况

##### 二、2009-2010年公司经营与销售情况分析

##### 三、2009-2010年公司竞争优势分析

##### 四、公司国际化战略发展

#### 第四节 新揚科技股份有限公司

##### 一、公司基本概况

##### 二、2009-2010年公司经营与销售情况分析

##### 三、2009-2010年公司竞争优势分析

##### 四、公司国际化战略发展

## 第五节 亚洲电材企业集团亚洲电材股份有限公司

- 一、公司基本概况
- 二、2009-2010年公司经营与销售情况分析
- 三、2009-2010年公司竞争优势分析
- 四、公司国际化战略发展

## 第六节 旗胜科技股份有限公司

- 一、公司基本概况
- 二、2009-2010年公司经营与销售情况分析
- 三、2009-2010年公司竞争优势分析
- 四、公司国际化战略发展

## 第七节 东丽世韩有限公司

- 一、公司基本概况
- 二、2009-2010年公司经营与销售情况分析
- 三、2009-2010年公司竞争优势分析
- 四、公司国际化战略发展

## 第八节 SD 电线有限公司

- 一、公司基本概况
- 二、2009-2010年公司经营与销售情况分析
- 三、2009-2010年公司竞争优势分析
- 四、公司国际化战略发展

## 第五章 2009-2010年中国挠性覆铜板产业运营态势分析

### 第一节 2009-2010年中国挠性覆铜板产业发概况

- 一、国内挠性覆铜板产品结构分析
- 二、中国挠性覆铜板应用情况分析
- 三、中国挠性覆铜板生产情况分析

### 第二节 2009-2010年中国挠性覆铜板市场运行现状分析

- 一、挠性覆铜板需求格局分析
- 二、中国挠性覆铜板市场发展机遇分析
- 三、挠性覆铜板市场最新动态分析

### 第三节 2009-2010年中国挠性覆铜板发展存在的问题与对策分析

## 第六章 2009-2010年中国挠性覆铜板相关行业发展形势分析

### 第一节 2009-2010年中国挠性印制电路业发展分析

- 一、我国FPC生产现状
- 二、我国FPC生产企业的现状
- 三、我国FPC业技术的现状

## 第二节 二层型挠性覆铜板在LCD的IC驱动用COF市场现状与发展

- 一、驱动IC用COF
- 二、驱动IC用COF挠性基板的性能特点及市场发展
- 三、我国COF挠性基板生产现状

## 第七章 2008-2010年中国挠性覆铜板相关行业主要数据监测分析

### 第一节 2008-2010年中国挠性覆铜板相关行业总体数据分析

- 一、2008年中国挠性覆铜板相关行业全部企业数据分析
- 二、2009年中国挠性覆铜板相关行业全部企业数据分析
- 三、2010年中国挠性覆铜板相关行业全部企业数据分析

### 第二节 2008-2010年中国挠性覆铜板相关行业不同规模企业数据分析

- 一、2008年中国挠性覆铜板相关行业不同规模企业数据分析
- 二、2009年中国挠性覆铜板相关行业不同规模企业数据分析
- 三、2010年中国挠性覆铜板相关行业不同规模企业数据分析

### 第三节 2008-2010年中国挠性覆铜板相关行业不同所有制企业数据分析

- 一、2008年中国挠性覆铜板相关行业不同所有制企业数据分析
- 二、2009年中国挠性覆铜板相关行业不同所有制企业数据分析
- 三、2010年中国挠性覆铜板相关行业不同所有制企业数据分析

## 第八章 2009-2010年中国覆铜板重点企业竞争力与关键性财务分析

### 第一节 依顿(广东)电子科技有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

### 第二节 山东金宝电子股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

### 第三节 金安国纪科技股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

#### 第四节 陕西生益科技有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

#### 第五节 无锡宏仁电子材料科技有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

#### 第六节 江门建滔积层板有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

#### 第七节 苏州松下电工有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

#### 第八节 依顿(中山)多层线路板有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第九节 国际层压板材有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第十节 略.....

第九章2009-2010年中国印刷电路板行业市场运行现状分析

第一节2009-2010年中国印刷电路板行业的总体概况

一、中国印刷电路板行业增长速度远高于行业平均速度

二、我国将成为世界最大产业基地

三、台湾柔性PCB公司在华东形成产业集群

四、低端PCB（4层以下）竞争比较充分，集中度较低

五、高端PCB（HDI等）处于供不应求的状态

第二节2009-2010年我国印刷电路板市场发展现状分析

一、印刷电路板市场生产结构分析

二、印刷电路板市场需求特点分析

三、印刷电路板市场技术发展分析

第三节 2009-2010年我国印刷电路板行业发展存在的主要问题分析

一、产品集中于中低端成本转嫁能力弱

二、应对专利和新环保政策

三、内地本土所贡献的产出值比例很小

第四节 2009-2010年中国印刷电路行业发展对策分析

第十章 2009-2010年中国挠性覆铜板用主要原材料业运行动态分析

第一节 挠性覆铜板用绝缘基膜--PI薄膜

一、绝缘基膜的生产方式

二、FCCL发展对绝缘基膜性能提出了更高的要求

三、世界FCCL用PI薄膜在品种和性能上的发展

第二节 挠性覆铜板用导电材料

一、各类铜箔的品种及特征

二、压延铜箔

三、电解铜箔

四、FCCL发展对铜箔性能提出更高的要求

第三节 挠性覆铜板用胶粘剂

一、FPC用胶粘剂发展概述

二、丙烯酸酯粘合剂研究与应用的状况

三、环氧树脂粘合剂研究与应用的状况

四、聚酰亚胺粘合剂研究与应用的状况

五、世界FPC及FCCL用胶粘剂的主要生产厂家及品种

第四节 挠性覆铜板用覆盖膜

第十一章 2011-2015年中国挠性覆铜板行业发展前景预测分析

第一节 2011-2015年中国挠性覆铜板行业发展趋势分析

一、2011-2015年中国挠性覆铜板行业发展走向分析

二、对未来FPC技术发展的预测

三、FPC发展对FCCL提出更高性能的要求

第二节 2011-2015年中国挠性覆铜板行业市场预测分析

一、挠性覆铜板供给预测

二、挠性覆铜板市场需求预测

三、挠性覆铜板产品价格走势预测

第三节 2011-2015年中国挠性覆铜板行业盈利能力预测

第十二章 2011-2015年中国挠性覆铜板行业投资机会与风险分析

第一节 2011-2015年中国挠性覆铜板行业投资环境分析

第二节 2011-2015年挠性覆铜板行业投资机会分析

一、规模的发展及投资需求分析

二、总体经济效益判断

三、与产业政策调整相关的投资机会分析

第三节 2011-2015年中国挠性覆铜板行业投资风险分析

一、市场竞争风险

二、原材料压力风险分析

三、技术风险分析

四、政策和体制风险

五、外资进入现状及对未来市场的威胁

图表目录：（部分）

图表：2005-2009年国内生产总值

图表：2005-2009年居民消费价格涨跌幅度

图表：2009年居民消费价格比上年涨跌幅度（%）

图表：2005-2009年年末国家外汇储备

图表：2005-2009年财政收入

图表：2005-2009年全社会固定资产投资

图表：2009年分行业城镇固定资产投资及其增长速度（亿元）

图表：2009年固定资产投资新增主要生产能力

图表：2006-2010年5月中国印制电路板制造行业企业数量及增长率分析 单位：个

图表：2006-2010年5月中国印制电路板制造行业亏损企业数量及增长率分析 单位：个

图表：2006-2010年5月中国印制电路板制造行业从业人数及同比增长分析 单位：个

图表：2006-2010年5月中国印制电路板制造企业总资产分析 单位：亿元

图表：2010年中国印制电路板制造行业不同类型企业数量 单位：个

图表：2010年中国印制电路板制造行业不同所有制企业数量 单位：个

图表：2010年中国印制电路板制造行业不同类型销售收入 单位：千元

图表：2010年中国印制电路板制造行业不同所有制销售收入 单位：千元

图表：2006-2010年5月中国印制电路板制造产成品及增长分析 单位：亿元

图表：2006-2010年5月中国印制电路板制造工业销售产值分析 单位：亿元

图表：2006-2010年5月中国印制电路板制造出口交货值分析 单位：亿元

图表：2006-2010年5月中国印制电路板制造行业销售成本分析 单位：亿元

图表：2006-2010年5月中国印制电路板制造行业费用分析 单位：亿元

图表：2006-2010年5月中国印制电路板制造行业主要盈利指标分析 单位：亿元

图表：2006-2010年5月中国印制电路板制造行业主要盈利能力指标分析

图表：依顿(广东)电子科技有限公司主要经济指标走势图

图表：依顿(广东)电子科技有限公司经营收入走势图

图表：依顿(广东)电子科技有限公司盈利指标走势图

图表：依顿(广东)电子科技有限公司负债情况图

图表：依顿(广东)电子科技有限公司负债指标走势图

图表：依顿(广东)电子科技有限公司运营能力指标走势图

图表：依顿(广东)电子科技有限公司成长能力指标走势图

图表：山东金宝电子股份有限公司主要经济指标走势图

图表：山东金宝电子股份有限公司经营收入走势图

图表：山东金宝电子股份有限公司盈利指标走势图

图表：山东金宝电子股份有限公司负债情况图

图表：山东金宝电子股份有限公司负债指标走势图

图表：山东金宝电子股份有限公司运营能力指标走势图

图表：山东金宝电子股份有限公司成长能力指标走势图

图表：金安国纪科技股份有限公司主要经济指标走势图

图表：金安国纪科技股份有限公司经营收入走势图

图表：金安国纪科技股份有限公司盈利指标走势图

图表：金安国纪科技股份有限公司负债情况图

图表：金安国纪科技股份有限公司负债指标走势图

图表：金安国纪科技股份有限公司运营能力指标走势图

图表：金安国纪科技股份有限公司成长能力指标走势图

图表：陕西生益科技有限公司主要经济指标走势图

图表：陕西生益科技有限公司经营收入走势图

图表：陕西生益科技有限公司盈利指标走势图

图表：陕西生益科技有限公司负债情况图

图表：陕西生益科技有限公司负债指标走势图

图表：陕西生益科技有限公司运营能力指标走势图

图表：陕西生益科技有限公司成长能力指标走势图

图表：无锡宏仁电子材料科技有限公司主要经济指标走势图

图表：无锡宏仁电子材料科技有限公司经营收入走势图

图表：无锡宏仁电子材料科技有限公司盈利指标走势图

图表：无锡宏仁电子材料科技有限公司负债情况图

图表：无锡宏仁电子材料科技有限公司负债指标走势图

图表：无锡宏仁电子材料科技有限公司运营能力指标走势图

图表：无锡宏仁电子材料科技有限公司成长能力指标走势图

图表：江门建滔积层板有限公司主要经济指标走势图

图表：江门建滔积层板有限公司经营收入走势图

图表：江门建滔积层板有限公司盈利指标走势图

图表：江门建滔积层板有限公司负债情况图

图表：江门建滔积层板有限公司负债指标走势图

图表：江门建滔积层板有限公司运营能力指标走势图

图表：江门建滔积层板有限公司成长能力指标走势图

图表：苏州松下电工有限公司主要经济指标走势图

图表：苏州松下电工有限公司经营收入走势图

图表：苏州松下电工有限公司盈利指标走势图

图表：苏州松下电工有限公司负债情况图

图表：苏州松下电工有限公司负债指标走势图

图表：苏州松下电工有限公司运营能力指标走势图

图表：苏州松下电工有限公司成长能力指标走势图

图表：依顿(中山)多层线路板有限公司主要经济指标走势图

图表：依顿(中山)多层线路板有限公司经营收入走势图

图表：依顿(中山)多层线路板有限公司盈利指标走势图

图表：依顿(中山)多层线路板有限公司负债情况图

图表：依顿(中山)多层线路板有限公司负债指标走势图

图表：依顿(中山)多层线路板有限公司运营能力指标走势图

图表：依顿(中山)多层线路板有限公司成长能力指标走势图

图表：国际层压板材有限公司主要经济指标走势图

图表：国际层压板材有限公司经营收入走势图

图表：国际层压板材有限公司盈利指标走势图

图表：国际层压板材有限公司负债情况图

图表：国际层压板材有限公司负债指标走势图

图表：国际层压板材有限公司运营能力指标走势图

图表：国际层压板材有限公司成长能力指标走势图

图表：略.....

更多图表见报告正文

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/tonglv/8856788567.html>